

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成19年4月5日(2007.4.5)

【公開番号】特開2001-226580(P2001-226580A)

【公開日】平成13年8月21日(2001.8.21)

【出願番号】特願2000-41535(P2000-41535)

【国際特許分類】

C 08 L	77/00	(2006.01)
C 08 G	59/30	(2006.01)
C 08 K	3/32	(2006.01)
C 08 K	7/18	(2006.01)
C 08 L	25/18	(2006.01)
C 08 L	63/02	(2006.01)
C 08 L	71/12	(2006.01)

【F I】

C 08 L	77/00
C 08 G	59/30
C 08 K	3/32
C 08 K	7/18
C 08 L	25/18
C 08 L	63/02
C 08 L	71/12

【手続補正書】

【提出日】平成19年2月19日(2007.2.19)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】(A)ポリアミド、ならびに(B)フェノールに不溶な有機物を含有し、リンに対する金属元素のモル比が1.3~2.5であるアパタイト型化合物からなり、該有機物がアパタイト型化合物100重量部に対し0.5~100重量部であるポリアミド複合体に、(C)臭素系難燃剤を配合してなるポリアミド樹脂組成物。

【請求項2】ポリアミド形成成分と、リンに対する金属元素のモル比が1.5~2.0であるリン酸系金属化合物と非リン酸系金属化合物との混合物からなるアパタイト型化合物形成成分とを配合し、ポリアミドの重合反応およびアパタイト型化合物の合成反応を行なせて得られるポリアミド複合体に、臭素系難燃剤を配合してなるポリアミド樹脂組成物。

【請求項3】(C)臭素系難燃剤が臭素化ポリスチレン、臭素化ポリフェニレンエーテル、臭素化ビスフェノール型エポキシ系重合体および臭素系架橋芳香族重合体からなる化合物類から選ばれる少なくとも1種であることを特徴とする請求項1あるいは2記載のポリアミド樹脂組成物。

【請求項4】アパタイト型化合物が、平均粒子径にして0.001~1μmであることを特徴とする請求項1あるいは2記載のポリアミド樹脂組成物。

【請求項5】アパタイト型化合物形成成分が、平均粒子径にして0.001~10μmであることを特徴とする請求項2記載のポリアミド樹脂組成物。

【請求項6】(A)ポリアミド100重量部に対して、(B)アパタイト型化合物0.5

～300重量部、(C)臭素系難燃剤1～300重量部であることを特徴とする請求項1～5いずれかに記載のポリアミド樹脂組成物。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0006

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0006】

すなわち本発明は、

(1)(A)ポリアミド、ならびに(B)フェノール溶媒に不溶な有機物を含有し、リンに対する金属元素のモル比が1.3～2.5であるアパタイト型化合物からなり、該有機物がアパタイト型化合物100重量部に対し0.5～100重量部であるポリアミド複合体に、(C)臭素系難燃剤を配合してなるポリアミド樹脂組成物、

(2)ポリアミド形成成分と、リンに対する金属元素のモル比が1.5～2.0であるリン酸系金属化合物と非リン酸系金属化合物との混合物からなるアパタイト型化合物形成成分とを配合し、ポリアミドの重合反応およびアパタイト型化合物の合成反応を進行させて得られるポリアミド複合体に、臭素系難燃剤を配合してなるポリアミド樹脂組成物、

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0007

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0007】

(3)(C)臭素系難燃剤が臭素化ポリスチレン、臭素化ポリフェニレンエーテル、臭素化ビスフェノール型エポキシ系重合体および臭素系架橋芳香族重合体からなる化合物類から選ばれる少なくとも1種であることを特徴とする上記1あるいは2記載のポリアミド樹脂組成物、

(4)アパタイト型化合物が、平均粒子径にして0.001～1μmであることを特徴とする上記1あるいは2記載のポリアミド樹脂組成物、

(5)アパタイト型化合物形成成分が、平均粒子径にして0.001～10μmであることを特徴とする上記2記載のポリアミド樹脂組成物、

(6)(A)ポリアミド100重量部に対して、(B)アパタイト型化合物0.5～300重量部、(C)臭素系難燃剤1～300重量部であることを特徴とする上記1～5記載のポリアミド樹脂組成物、

である。以下、本発明について詳細に説明する。